

# 【主要設備一覧】 2019/02/12



株式会社シンセイ電子  
<http://www.sinsei-group.com>  
 TEL:045-633-8811 FAX: 045-633-8280

No.	工程名	分類	型名	台数	メーカー名	対応基板サイズ	その他
1	SMT	クリームはんだ印刷機	TSP-600	1	天竜精機	Min: X50mm~Y50mm Max: X335mm~Y255mm	・対応メタルマスクサイズ ⇒650mm×550mm ・スキージアタック角: 60°
2		3Dはんだ印刷検査装置	VP3000	1	CKD	Min: X50mm~Y50mm Max: X330mm~Y250mm	
3		チップマウンター	YV100Xg	2	ヤマハ	Min: X50mm~Y50mm Max: X460mm~Y440mm 基板厚: 0.4~3.0mm	・0603標準対応
4			YG100RB	1		Min: X50mm~Y50mm Max: X510mm~Y440mm 基板厚: 0.4~3.0mm	・0603標準対応
5			RS-1	1		JUKI	Min: X50mm~Y50mm Max: X650mm~Y370mm 基板厚: 0.3~4.0mm
6		リフロー	SNR-840GT	1	千住金属工業	Min: X100mm~Y50mm Max: X500mm~Y400mm 基板厚: 0.8~4.0mm	・コンベア乗り代: 5.0mm
7		リフロー	SENSBEY JN-3507NL	1	日本電熱計器	Min: X50mm~Y70mm Max: X470mm~Y350mm 基板厚: 0.8~3.0mm	・コンベア乗り代: 4.0mm
8	フロー	スプレーフラクサー	MXL-350V	1	日本電熱計器	Min: X120mm~Y60mm Max: X400mm~Y350mm 基板厚: 0.8~3.0mm	・コンベア乗り代: 5.0mm
9		フローはんだ付け装置	DTFS-35EM	1	ダイトクテック	Min: X120mm~Y60mm Max: X400mm~Y350mm 基板厚: 0.6mm~2.6mm	・鉛フリー (組成: Sn96.5-Ag3-Cu0.5) ・コンベア乗り代: 5.0mm
10		フローはんだ付け装置	HC33-32LF2	1	タムラ製作所	Min: X120mm~Y50mm Max: X350mm~Y350mm 基板厚: 0.6mm~1.6mm	・共晶 ・コンベア乗り代: 5.0mm
11	ポイント ソルダー	セレクトティブソルダー	STS-5050SJ	1	セイテック	Min: X50mm~Y50mm Max: X500mm~Y500mm 基板厚: 0.8mm~3.0mm	・鉛フリー (組成: Sn96.5-Ag3-Cu0.5) ・コンベア乗り代: 3.0mm
12		スポット噴流槽	SOLDER ACE	2	アジア電子工業		・共晶、鉛フリーはんだ
13			TOP-323	1	テクノデザイン工業		・低融点鉛フリーはんだ
14	非破壊検査	X線検査装置	TOSMICRON-C3090IN	1	東芝ITコントロールシステムズ		
15	外観検査	外観検査装置 (AOI)	U22XMA-650	1	マランツエレクトロニクス	Min: X50mm~Y50mm Max: X650mm~Y540mm 基板厚: 0.4mm~2.0mm	
16			M22XDL-350	1	マランツエレクトロニクス	Min: X50mm~Y50mm Max: X350mm~Y250mm 基板厚: 0.5mm~2.0mm	
17			BPC-168DT	1	DJ-TECH	Min: X50mm~Y50mm Max: X460mm~Y360mm 基板厚: 0.6mm~2.0mm	
18	リワーク	リワーク機	MS9000SAN	1	メイショウ	Min: X50mm~Y50mm Max: X400mm~Y500mm 基板厚: 0.5mm~3.5mm	・保有ノズル: 計11種